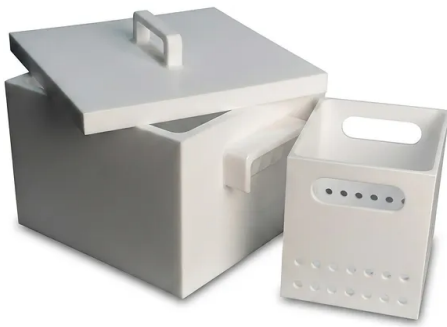


Kundenspezifischer Ptfе-Viereckbehälter Für Die Halbleiterindustrie - Säurebeständiges Fluoropolymer-Filtrationsgefäß Zum Einweichen Und Reinigen

Artikelnummer: PL-CP53



Einführung

Maximieren Sie die Effizienz in der Halbleiterfertigung mit unseren maßgefertigten PTFE-Viereckbehältern, entwickelt für überlegene Säurebeständigkeit und Reinheit bei der Spurenanalyse. Diese Hochleistungs-Fluoropolymergefäße gewährleisten ein kontaminationsfreies Einweichen und einen zuverlässigen Chemikalienumgang für anspruchsvolle Labor- und Industrieprozesse von heute.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Halbleiter-Wafer-Ätzen	Eintauchen von Silizium-Wafern in konzentrierte Säurebäder zur Oberflächenmodifikation und Kontaminantenentfernung.	Verhindert metallische Ionenkontamination und widersteht aggressiven HF/HNO ₃ -Gemischen.
Solarzellen-Verarbeitung	Texturieren und Reinigen von Silizium-Substraten in großtechnischen Photovoltaik-Fertigungslinien.	Hochvolumen-Haltbarkeit und Beständigkeit gegen alkalische Ätzlösungen.
Spurenanalyse-Probenvorbereitung	Säureaufschluss und Einweichen von Laborgeräten, um eine Grundlinie von Null Kontamination sicherzustellen.	Ultraniedriges Auslagverhalten, essentiell für PPT-Nachweisgrenzen.
Edelmetallrückgewinnung	Verwendung als Reaktions- oder Einweichgefäß für die Auflösung von Metallen in Königswasser oder Cyanidlösungen.	Volle Immunität gegen oxidativen Angriff und Hochtemperaturstabilität.
Reinigung von Luftfahrtkomponenten	Entfetten und Entzundern von hochpräzisen Motorkomponenten mit korrosiven Chemikalien.	Langfristige Zuverlässigkeit in rauen Industrieumgebungen mit hohen Lastzyklen.
Pharmazeutische Chemiesynthese	Dient als Primärgefäß für den Umgang mit korrosiven Reagenzien in der hochreinen Arzneimittelherstellung.	FDA-Konformität und einfache Sterilisation aufgrund der antihafte Oberfläche.
Batterieforschung und -test	Einweichen von Elektrodenmaterialien in Elektrolytlösungen für beschleunigte Alterung und Leistungstests.	Chemische Kompatibilität mit verschiedenen Lithiumsalzen und organischen Carbonaten.
Mikroelektronik-Photoresist-Entfernung	Entfernen organischer Beschichtungen von Substraten mit speziellen Lösungsmittelgemischen bei erhöhten Temperaturen.	Behält strukturelle Integrität unter thermischer Belastung und Lösungsmittlexposition.

Parameter	Spezifikation für PL-CP53
Basismaterial	100% Neues Hochdichte PTFE (Polytetrafluorethylen)
Optionale Materialien	PFA (Perfluoralkoxy) für verbesserte Transparenz oder chemische Reinheit
Abmessungen (L x B x H)	Vollständig anpassbar (Angepasst an Kundenarbeitsplatz und Chargengröße)
Wandstärkenbereich	Anpassbar (Standard 5mm bis 30mm+ basierend auf Volumen)
Betriebstemperaturbereich	-200°C bis +260°C (-328°F bis +500°F)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Parameter	Spezifikation für PL-CP53	
Chemische Kompatibilität	Universell (Außer geschmolzene Alkalimetalle und bestimmte Fluorierungsmittel)	
Fertigungsmethode	5-Achsen-CNC-Bearbeitung / Hochpräzisionsschweißen (nach Bedarf)	
Interne Merkmale	Anpassbare Einbauten, Filterspalten und etagierte Halterungen	
Entwässerungssysteme	Optionale integrierte PTFE-Kugelhähne oder NPT-Gewindeanschlüsse	
Deckelkonfiguration	Aufliegend, verschraubt oder aufgeklappte PTFE-Abdeckungen verfügbar	
Oberflächengüte	Gefräst glatt (Ra < 0,8 µm auf Anfrage verfügbar)	
Belastbarkeit	Konstruiert für spezifische Materialdichten und Volumen	